



电子行业研究

买入（维持评级）

行业周报(简报)

证券研究报告

电子组

分析师：樊志远（执业 S1130518070003） 分析师：刘妍雪（执业 S1130520090004） 分析师：邵广雨（执业 S1130522080002）
 fanzhiyuan@gjzq.com.cn liuyanxue@gjzq.com.cn shaoguangyu@gjzq.com.cn

分析师：邓小路（执业 S1130520080003） 分析师：丁彦文（执业 S1130524070002）
 dengxiaolu@gjzq.com.cn dingyanwen@gjzq.com.cn

云厂商 Q2 资本开支乐观，英伟达 GB200 延后不改向好趋势

电子周观点：

云厂商 Q2 资本开支乐观，英伟达 GB200 延后不改向好趋势。根据 The Information 及台湾工商时报信息，由于设计缺陷、COWOS-L 良率低及产能问题，英伟达 Blackwell 架构系列 AI 旗舰芯片 GB200 的出货时间，将被推迟至少三个月。我们认为，从历史经验看，技术、工艺问题解决只是时间问题，从云厂商公布的资本开支来看，AI 算力需求并未减少，微软 2024 年第二季度的资本支出 190 亿美元，同比大增 77.6%，环比增长 35.7%；亚马逊 2024 年上半年资本开支已达 305 亿美元，并表示下半年继续增加资本开支；谷歌 2024 年二季度资本开支达到 130 亿美元，预计全年每季度的资本支出将大致保持在 120 亿美元左右。我们认为 AI 云端算力板块短期承压，不改向好趋势，随着 B 系列芯片问题的解决，产业链将迎来较好的拉货机会。苹果公布 2024 年 Q2 业绩，收入 857.8 亿美元、同增 5%，Q2 公司活跃设备安装基数在所有产品和地理区域均创下历史新高，预计 Q3 延续同比增速。苹果发布了《Apple Intelligence 基石模型技术报告》，苹果将持续打造芯片、系统、硬件创新及端侧 AI 模型的核心竞争，苹果 AI 技术及硬件创新有望拉动硬件换机需求，苹果产业链有望迎来量价齐升。我们认为，电子进入三季度拉货旺季，AI 给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看消费电子创新/需求复苏、自主可控及好 AI 驱动受益产业链。

细分赛道：1) 半导体代工：台积电 6 月营收同比增长 32.9%，环比减少 9.5%。联电 6 月营收同比减少 7.9%，环比下滑 10.1%。中芯国际 24Q2 营收指引为环比增长 5-7%。2) 工业、汽车、安防、消费电子：根据 Canalys，2024 年 Q2 全球 PC 出货量达 6280 万台，同增 3.4%。2024 年 Q2 全球智能手机出货量达 2.88 亿台、同增 12%。6 月 11 日苹果首个生成式 AI 大模型 Apple Intelligence 正式登场，重新定义 AI 手机，Apple Intelligence 测试版将于今年秋季作为 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 的内置功能推出。根据乘联会，6 月新能源乘用车销量为 97 万辆、同增 28%。3) PCB：从 PCB 产业链整体情况来看，二季度整个行业的景气度持续回升，不过值得注意的是 6 月 PCB 制造环节环比承压严重，虽然有一部分原因来自于中国台湾地区电力供应紧张导致的稼动受限。4) 元件：关注 Q2 电视品牌厂及 ODM 销量及库存，大尺寸处于长期价格上涨通道。Q2 小尺寸 MiniLED 有望加速渗透。《经济日报》报道，受益于智能手机及 PC 需求回暖、传统旺季来临，叠加银价大涨，村田、TDK 等正酝酿调涨产品报价，涨价产品初步锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达 20%。5) IC 设计：存储大厂转向 DDR5/HBM，A 股利基型存储厂商迎来发展机会。随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向 DDR5 及 HBM 等未来需求强劲的领域，将加快退出利基存储市场。

投资建议与估值

电子进入三季度拉货旺季，AI 给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，下半年智能手机、AI PC 将迎来众多新机发布，云厂商 Q2 资本开支乐观，英伟达 GB200 延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、自主可控及 AI 驱动受益产业链。重点受益公司：立讯精密、水晶光电、鹏鼎控股、沪电股份、蓝思科技。

风险提示

需求恢复不及预期的风险；AIGC 进展不及预期的风险；外部制裁进一步升级的风险。



一、细分板块观点

1.1 汽车、工业、消费电子：消费电子需求向好，AI 边缘未来可期

1) 消费电子：①根据 Canalys，2024 年 Q2 全球 PC 出货量达 6280 万台，同增 3.4%。2024 年 Q2 全球智能手机出货量达 2.88 亿台、同增 12%。②6 月 11 日苹果首个生成式 AI 大模型 Apple Intelligence 正式登场，目前仅支持英语，只能用于 iPhone 15 Pro 或更高版本手机、M 系列的 iPad、Mac。软件系统升级对算力要求更高，有助于带动新一波换机周期。③AI 眼镜销量超预期，我们估算 2024 年 Q2 Meta Ray-Ban 出货量或达 50 万台，年化销量达 200 万台。④预计未来伴随更多 AI 手终端，消费电子需求持续向好，建议关注品牌公司（苹果、小米集团、传音控股、联想集团）、手机供应链（立讯精密、鹏鼎控股等）、PC 供应链（珠海冠宇）、XR 供应链（歌尔股份、龙旗技术、水晶光电）。

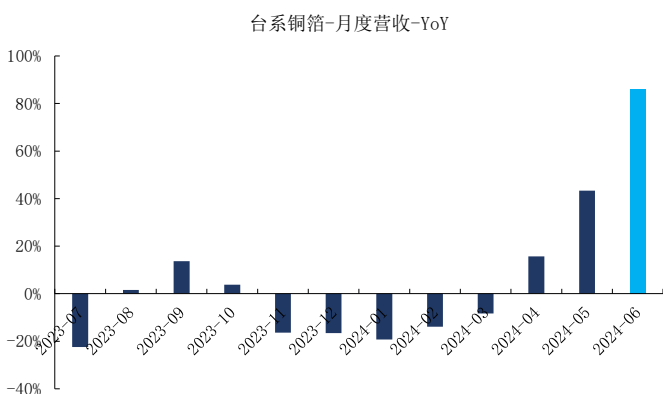
2) 汽车：关注智能化+电动化。①根据乘联会，7 月新能源乘用车销量为 95 万辆、同增 29%。预计 2024 年新能源乘用车销量为 1100 万辆，同增 22%。②特斯拉计划于 10 月发布 Robotaxi，有望加速智能驾驶进程。③建议积极关注智能化（电连技术、永新光学、京东方精电、舜宇光学科技、宇瞳光学、联创电子、水晶光电）。电动化（瑞可达、永贵电器、维峰电子、法拉电子、中熔电气）等标的。

3) 光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力。伴随美国制裁加剧，建议积极关注光刻机光学公司（晶方科技、茂莱光学、福晶科技、腾晶科技、炬光科技等企业）。

1.2 PCB：6 月景气度持续回升，PCB 制造环节承压

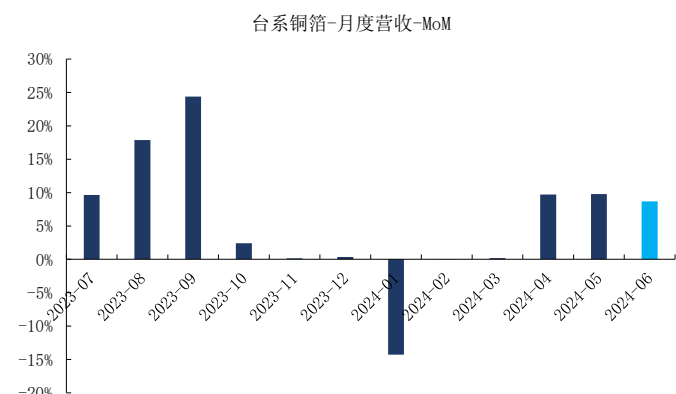
从 PCB 产业链整体情况来看，二季度整个行业的景气度持续回升，不过值得注意的是 6 月 PCB 制造环节承压严重，虽然有一部分原因来自于中国台湾地区电力供应紧张导致的稼动受限，整个行业进入 7 月后排产紧张的情况预计有所缓解，或呈现旺季平淡的情况。

图表1：台系电子铜箔厂商月度营收同比增速



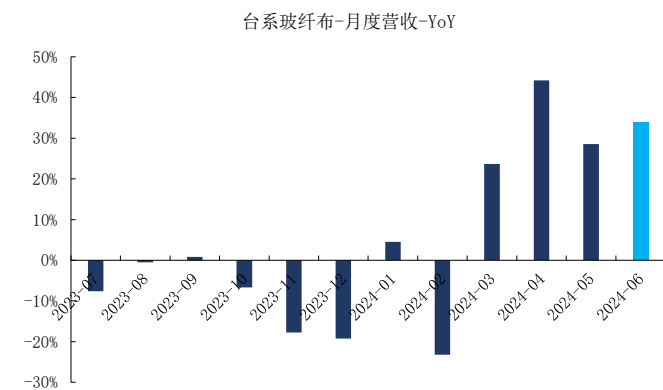
来源：Wind，国金证券研究所

图表2：台系电子铜箔厂商月度营收环比增速



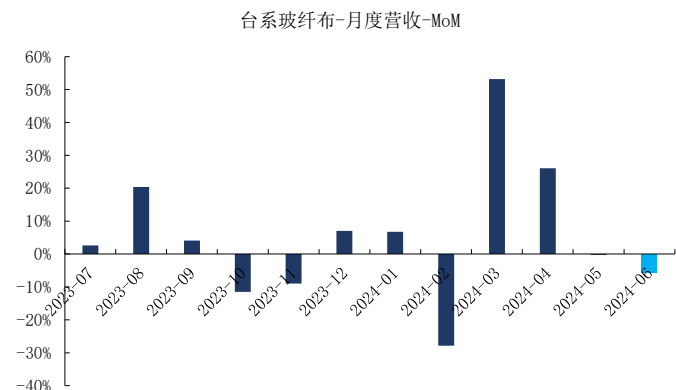
来源：Wind，国金证券研究所

图表3：台系电子玻纤布厂商月度营收同比增速



来源：Wind，国金证券研究所

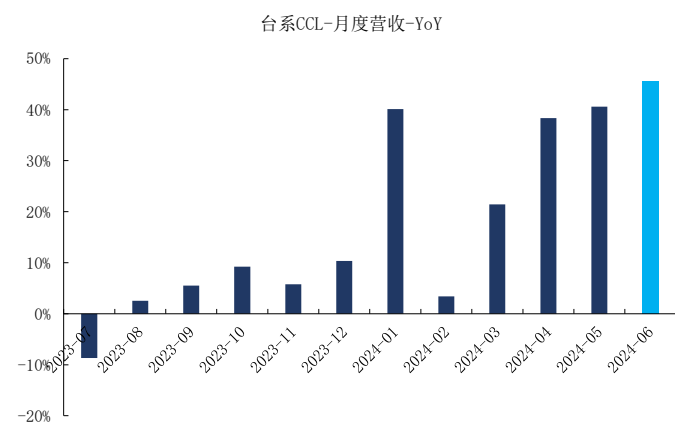
图表4：台系电子玻纤布厂商月度营收环比增速



来源：Wind，国金证券研究所

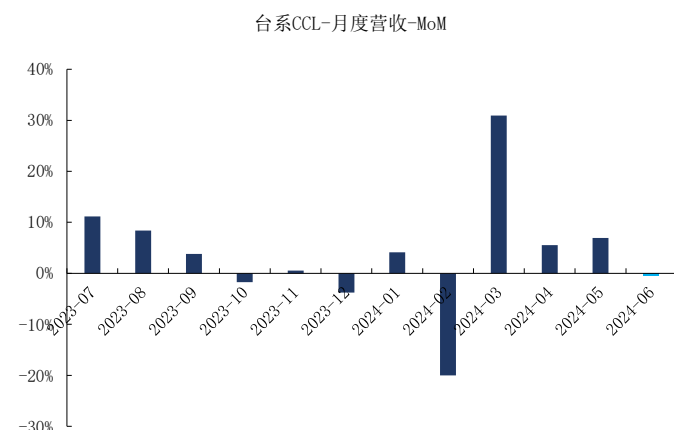


图表5: 台系覆铜板厂商月度营收同比增速



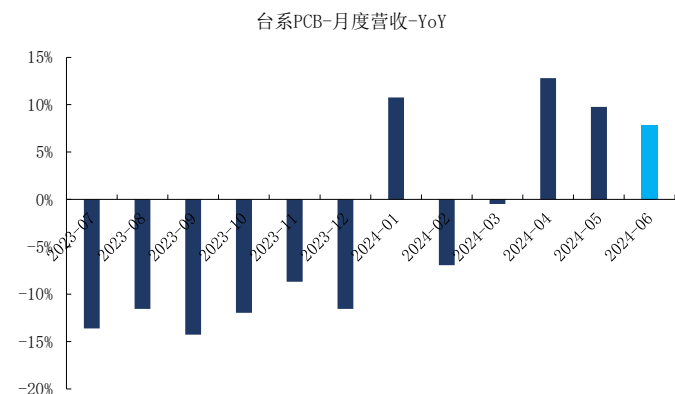
来源: Wind, 国金证券研究所

图表6: 台系覆铜板厂商月度营收环比增速



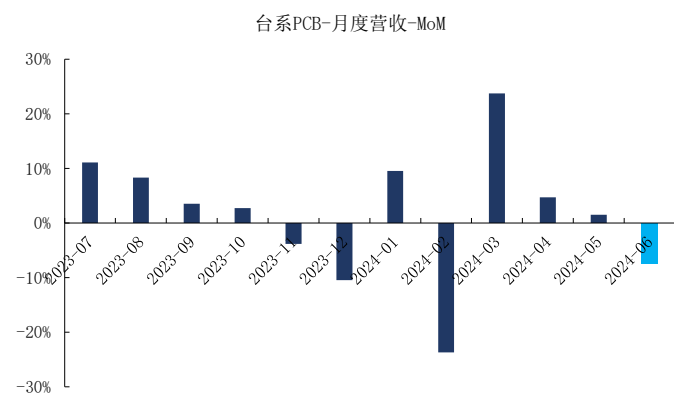
来源: Wind, 国金证券研究所

图表7: 台系PCB厂商月度营收同比增速



来源: Wind, 国金证券研究所

图表8: 台系PCB厂商月度营收环比增速



来源: Wind, 国金证券研究所

1.3 元件: 被动元件有望涨价, AI 终端升级带动产品升级

1) 被动元件: 有望涨价, AI 终端升级带动升级

《经济日报》报道, 受益于智能手机及 PC 需求回暖、传统旺季来临, 叠加银价大涨, 村田、TDK 等正酝酿调涨产品报价, 涨价产品初步锁定积层式电感、磁珠等产品, 涨幅或达 20%。需求端持续改善, 成本传导海外领涨。本轮海外厂商价格领涨主要在成本传导, 顺利传导成本端不是重点, 核心是需求回暖, 下游接受度增强。

台系从 3 月开始月度营收同比增长持续至 6 月, 3-5 月环比持续增长, 6 月环比下滑, 原因: 1) 台系的产品结构更受益于服务器、手机、PC 复苏, Q2 拉货; 2) 6 月一定程度上受电力供应的影响, 有所下滑。3) 厂商预期后续 Q3 消费电子旺季, 稼动率还会持续往上走。

被动元件整体景气度稳中向好, 后续可能出现结构性涨价。需求端目前家电、AI 服务器比较旺盛, 消费、安防、车规、工控需求比较稳定, 国产厂商稼动率 Q2 在高位, 产业链库存多季度保持健康水位, 价格平稳。AI 相关、高容等产品供需格局更好, 预计基本面改善会持续, 后续需求恢复, 高稼动率的情况下, 量价维度可能出现结构性涨价或者扩产节奏加速。

AI 终端升级同样也带动被动元器件的升级。以电感为例, AI 服务器对于功耗要求更高, 芯片电感更适用于如 AI 服务器相关的高功耗、高散热要求的场景, 摩尔定律发展晶体管数量增多, 产品功耗瓦数升高, 对于散热的要求提升, 相较于铁氧体, 金属软磁粉芯在耐受电流方面性能更好。

以 MLCC 为例, 根据 Trendforce, 英特尔 2024 年新平台 Meteor Lake, 首发具备 AI 系统算力, 增加两组 NPU 供电线路, MLCC 用量额外增加每台约 90~100 颗。而随着新平台导入机种增加, 终端产品中 MLCC 用量需求将有所增加。以电感为例, CPU、GPU 对稳定供电和滤波方面的要求很高。一体成型电感, 具备耐大的直流偏置、温度稳定性好、小型化、薄型化、轻量化特点, 能在大电流的条件下长期工作, 具备良好的滤波特性, 能为 CPU 稳定供电。持续性方面, 产业升级趋势直接受益的为台系、日韩系, 因为有全球化客户的企业, A 股被动元件公司更侧重内循环安卓系客户, 后续关注安卓系 AI 产品推出的带动。

大尺寸电容方面, 2023 年由于新能源产业链去库降本传导, 消费、工业需求一般, 铝电解电容、薄膜电容均承担了



较大的价格压力，且影响了 23H2 的订单量和订单节奏。目前产业链已到了去库尾声，价格已到底部，后续降价幅度可控，需求端，新能源应用尤其海外户储的拉货需求已有所增长，叠加消费、工业类需求回暖，新能源汽车需求增速持续，下半年大尺寸电容公司的业绩有望进一步改善。

2) 面板：LCD 价格调整，关注 Q3 旺季拉货情况

LCD：控产情况下价格略有调整，关注 Q3 拉货情况

7 月下旬，电视价格下滑。上半年涨价，供给端主要系面板厂商控制稼动率从而控制产业库存，需求端短期由于 TV 品牌厂为保证 6 月欧洲杯、7-8 月奥运会的交货而拉货，预期涨价从而加紧备货进一步促进涨价。从 Q3 的情况来看，面板厂持续调整稼动率，消化 3-5 月的备货库存，目前消库阶段控制价格跌幅，关注后续 8、9 月备货四季度拉货情况，长期来看 LCD 供需格局改善，中游制造环节价值凸显，大尺寸处于长期价格上涨通道。建议关注彩虹股份、京东方 A、TCL 科技。

OLED：Q3 更多新机发布，看好价格上涨&上游国产化机会

供需格局改善，OLED 面板价格会持续上涨。需求端预计下半年消费电子拉货、中低端手机 OLED 渗透率提升、折叠屏放量、安卓米 OV 等加速国产替代（原三星）等拉动。

国内 OLED 产能释放、高世代线规划带动上游设备材料厂商需求增长+国产替代加速。8.6 代线单线有机发光材料用量远高于 6 代线，面积增加+叠层技术预计起码是 4 倍以上的消耗量。有机发光材料技术壁垒高、海外专利垄断，设备端蒸镀机、掩膜版美日企业主导，国内供应商正在加速面板厂导入验证。国内厂商加速下游面板厂配套合作、导入验证，建议关注奥来德、莱特光电、京东方 A、维信诺。

3) LED：Q2 内需较弱，长期关注 MINILED 背光及直显机会

软件环节受益：小间距渗透&高清升级&应用场景拓展带动增长。1) MINI/MICRO 显示技术升级，COB/MIP 等技术良率提升、成本下降，规模放量加速渗透，更小芯片&更小间距带动像素数量增加，显控产品销量需求有望增长。2) 4K/8K 视频高清化，带动像素密度提升，一方面推动显控产品升级带动 ASP 提升，另一方面有限带载能力下，增加产品数量需求。3) XR/虚拟拍摄/裸眼 3D 等应用场景拓展，覆盖更广泛场景，加速渗透商用、民用等新兴市场，建议关注诺瓦星云、卡莱特。

直显硬件端受益：供给端随着 COB 封装技术改进、直通良率提升，加速新技术应用，Mini LED 成本快速下降，需求端直显 B 端客户随着成本问题逐步解决接受度提升。根据洛图数据，2023 年 LED 屏出货面积主要集中在 P1.7-2.5 间距段，市占率 71.1%，P1.6-1.1 出货面积份额增长明显，COB 在微间距占比超四成。价格维度，LED 屏价格持续下探，中国小间距 LED 屏市场均价为 1.43 万元/平方米，P≤1.5 间距产品市场均价下滑幅度较大，P2.5-1.5 间距段的产品前期发展更成熟，价格下探空间有限，下滑相对平缓，建议关注兆驰股份。

1.4 IC 设计：存储大厂转向 DDR5/HBM，A 股利基型存储厂商迎来发展机会

5 月 13 日，根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大 DRAM 供应商韩国三星、SK 海力士全力冲刺 HBM 与主流 DDR5 规格内存，下半年起将停止供应 DDR3 利基型 DRAM，同时中国台湾最大 DRAM 芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向 DDR4 及 DDR5，DDR3 仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期 DDR3 价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。

供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向 DDR5 及 HBM 等未来需求强劲的领域，将加快退出利基存储市场。利基存储市场主要包括利基 DRAM（DDR2、DDR3、小容量 DDR4）、Nor Flash 和 SLC NAND 等。市场参与厂商主要包括三星、海力士、美光，其他为台系的南亚科、华邦电、旺宏以及大陆的长鑫、兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等。

需求端：利基存储器主要应用于 TV、家电、安防、IOT 等消费类需求以及基站、工业、汽车等，今年一季度以来非手机类消费电子特别是家电、耳机、IOT、电子烟等终端需求较快复苏，有望对利基存储器带来需求。

我们认为随着大厂产能加速转向 DDR5、HBM 等大容量高带宽存储器，而随着终端需求复苏，利基市场有望迎来短期的产能紧缺，价格迎来上扬。1) 利基存储龙头（DRAM+NorFlash+SLCNAND）：看好兆易创新；2) NorFlash 厂商：建议关注普冉股份、恒烁股份；3) SLC NAND 厂商：建议关注东芯股份；4) 汽车及工业类 DRAM 龙头：建议关注北京君正。

1.5 半导体代工、设备、材料、零部件观点：产业链逆全球化，自主可控逻辑加强

半导体代工、设备、材料、零部件观点：半导体产业链逆全球化，美日荷政府相继正式出台半导体制造设备出口管制措施，半导体设备自主可控逻辑持续加强，为国产半导体产业链逻辑主线。出口管制情况下国内设备、材料、零部件在下游加快验证导入，产业链国产化加速。

半导体代工&IDM：台积电 6 月营收同比增长 32.9%，环比减少 9.5%。联电 6 月营收同比减少 7.9%，环比下滑 10.1%。中芯国际 2024 年二季度营收指引为环比增长 5-7%。中芯国际 24Q1 营收 17.50 亿美元，同比+19.7%，环比+4.3%，毛利率为 13.7%，净利润 7179 万美元，同比-68.9%，环比-58.9%。中芯国际 2024 年二季度营收指引为环比增长 5-7%。整体而言我们看好中芯国际作为国内晶圆代工龙头，逆全球化为国产芯片产业链的基石，港股 PB 存在低估。

封测：先进封装需求旺盛，重视产业链投资机会。台积电在法说会上表示，AI 相关的先进封装产能需求很多。之前指



引为今年先进封装产能翻倍，但现在来看可能是不止翻倍，供给还是很紧张到 25 年，希望 26 年能有所缓解，客户需求非常旺盛。台积电 24 年 Capex 预期为 30~32B，其中 70~80% 是用于先进制程，10~20% 是特色工艺，10% 是先进封装等，25 年 CoWoS 产能预估较 2024 年翻倍或翻倍以上。国产算力需求旺盛，有望拉动国内先进封装产业链。算力需求旺盛，地缘政治因素影响下，算力端自主可控成为国产算力核心发展方向。寒武纪、华为昇腾等 AI 算力芯片需求旺盛，先进封装产能紧缺，持续扩产背景下先进封装产业链有望深度受益。此外，HBM 产能紧缺，国产 HBM 已取得突破，看好相关产业链标的。建议关注：甬矽电子、长电科技、通富微电、利扬芯片、伟测科技；封测设备及耗材：长川科技、金海通、和林微纳。

半导体设备板块：23 年头部晶圆厂的招标整体偏弱，24 年部分厂商的招标情况有希望有积极改善，部分存储厂商如果进展顺利有望拉动较大的国产设备投资，我们看好订单弹性较大的【中微公司/华海清科】，建议关注【拓荆科技】；另一方面消费电子补库，半导体需求端也在持续改善，随着周期走出底部，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，自主可控叠加复苏预期，我们持续看好设备板块，看好【北方华创/精测电子/中科飞测】。

半导体材料：看好稼动率回升后材料边际好转及自主可控下国产化的快速导入。材料相对后周期，行业 β 会受到一些半导体行业景气度的影响，从材料中报数据来看，部分渗透率高的公司营收业绩承压，三季报来看，材料端营收利润环比弱复苏。当前美国杜邦已经在逻辑和存储相应的制裁领域断供，日本加入了设备的制裁，材料风险也在增加。中长期看好平台化材料公司，短期看好光刻胶公司的催化机会，建议关注鼎龙股份、雅克科技、安集科技等。

二、重点公司

电子进入三季度拉货旺季，AI 给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，下半年智能手机、AI PC 将迎来众多新机发布，云厂商 Q2 资本开支乐观，英伟达 GB200 延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、自主可控及 AI 驱动受益产业链。重点受益公司：立讯精密、水晶光电、鹏鼎控股、沪电股份、蓝思科技、领益智造、歌尔股份、东山精密、北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、江丰电子、东睦股份、胜宏科技、生益电子、中际旭创、新易盛、天孚通信、铂科新材、生益科技、顺络电子、恒玄科技、晶晨股份、澜起科技、三环集团、传音控股、正帆科技、卓胜微、韦尔股份、兆易创新。

立讯精密：Apple Intelligence 重新定义 AI 边端，2025 年苹果换机周期可期。①软件方面，6 月苹果首个生成式 AI 大模型 Apple Intelligence 正式登场，Apple Intelligence 只能用于 iPhone 15 Pro 或更高版本机型；硬件方面，2025 年苹果有望发布 iPhone 17 Slim，Slim 款可能是十年来最大的外观改款；根据 IDC，2023 年苹果全球保有量达 8.4 亿台、换机周期在 3.6 年，软件+硬件创新有望带动新一轮换机潮。苹果是公司超级大客户，深度受益下游放量。②公司自 2020 年切入 iPhone 组装后、成为公司重要增长引擎。我们估算目前 iPhone 组装份额为 20%，预计未来伴随组装份额持续增长、利润率抬升，带动公司利润持续增长。③公司作为 Vision Pro 的 OEM 厂，未来有望深度受益产品放量周期。

沪电股份：高速通信类是保证公司成长的关键。公司高速通信产品主要用于交换机、服务器、运营商通信，客户覆盖包括国内外主要的设备商和云计算厂商，是 A 股 PCB 中涉及海外高速运算敞口最大的厂商，也是参与全球 AI 运算供应的关键厂商，未来有望随着 AI 市场扩容而实现快速增长。公司汽车类产品主要供应全球龙头 TIER1 厂商，并且依据多年的技术积累不断调整产品结构至覆盖多类域控制器用 HDI 产品，汽车智能化趋势将为公司带来成长贡献。

江丰电子：公司以溅射靶材业务为基础，战略布局半导体精密组件助力产业链自主可控。海外对中国大陆半导体行业的限制范围持续扩大，国产设备加速验证导入，半导体设备和零部件持续受益国产替代。1H2024 公司多个生产基地陆续完成建设并开始投产，依托半导体用靶材积累的技术积淀及客户优势，公司持续拓展产品线，大量新产品完成技术攻关，逐步从试制阶段推进到批量生产，半导体精密组件产品销售持续放量。

东睦股份：公司是国内粉末冶金行业龙头企业，主要从事粉末压制成形（P&S）、软磁复合材料（SMC）和金属注射成形（MIM）三大业务，PS 业务为国内龙头，SMC 业务产能为全球第一梯队，MIM 应用于折叠屏手机等消费电子领域，深度绑定国内大客户。公司产业链上下游布局，三大业务多元协同发展。

生益电子：公司是传统高速通信类覆铜板生产厂商，在服务器需要用到高多层板上具有深厚的技术积累，公司服务器类客户覆盖了国内主流客户群和海外部分客户，随着国内加大训练端算力需求、海外 AI 相关应用加速推出，公司服务器类 PCB 将迎来增长。

中际旭创：需求端：云厂商资本开支有望重回上行周期，并且在结构上向 AI 或网络基础设施倾斜。根据公司 23 年报转引 Factset 一致预期，24 年海外云巨头的（微软、亚马逊、苹果、Meta、谷歌）资本开支将同比增长 27.2% 至 1938.3 亿美元。在算力升级及需求增长等因素的驱动下，行业有望迎来快速上升期。供给端：募投项目持续扩充产能，1.6T 等新技术前瞻布局。公司持续推进苏州、铜陵以及海外生产基地建设，高端光模块产品产能爬坡顺利。公司在 OFC2023 上展出 1.6T 可插拔光模块，预计 24 年下半年部分重点客户将开始部署 1.6T 光模块，并且在 25 年规模上量。基于不同的网络架构，25 年也将有更多客户部署和上量 800G。同时公司持续布局硅光、相干、LP0、LR0、CP0 等前瞻技术，相关产品处于研发或验证阶段。

天孚通信：前瞻布局光引擎，有望成为公司业绩新增长极。随着数据中心互联带宽持续升级，光模块功耗、交换机端口密度、光电交换容量等问题凸显，光引擎成为集成度与性能兼优的解决方案。公司依托于无源器件和有源封装方面的技术沉淀积累，前瞻布局了高速光引擎解决方案。2020 年公司通过定增募集 7.86 亿元投向面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目。随着人工智能发展和算力需求的增加，800G/1.6T 等高速光模块需求逐渐释放，公司光引擎业务



有望迎来发展新机遇。

电连技术：汽车智能化持续加速，公司汽车连接器产品已进入吉利、长城、比亚迪、长安、奇瑞、理想等国内主要汽车厂商供应链。

顺络电子：受益于大客户拉货及安卓补库需求，传统业务订单增长较快；价格上公司 LTCC 等新产品持续导入客户供应体系带动 ASP 提升。公司消费通信类业务占比超过 50%，叠层等高毛利率产品产能利用率环比提升，带动利润率明显修复。公司持续多元化布局，汽车电子、光伏储能、云计算等新兴业务打开向上空间。在市场整体处于疲软的背景下，公司盈利能力实现快速恢复，传统业务营收稳中有升，新兴业务蓬勃发展。

传音控股：2023 年，公司手机整体出货量约 1.94 亿部、同增 24%。根据 IDC 数据统计，2023 年公司在全球手机市场的占有率 14.0%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为 8.1%（较 2023 年提升 2pct），排名第五、排名提升一位。根据 Canalys，2024 年 Q1 公司智能手机份额提升至 10%（较 2023 年 Q1 提升 4pct），排名第四，市场份额快速提升。

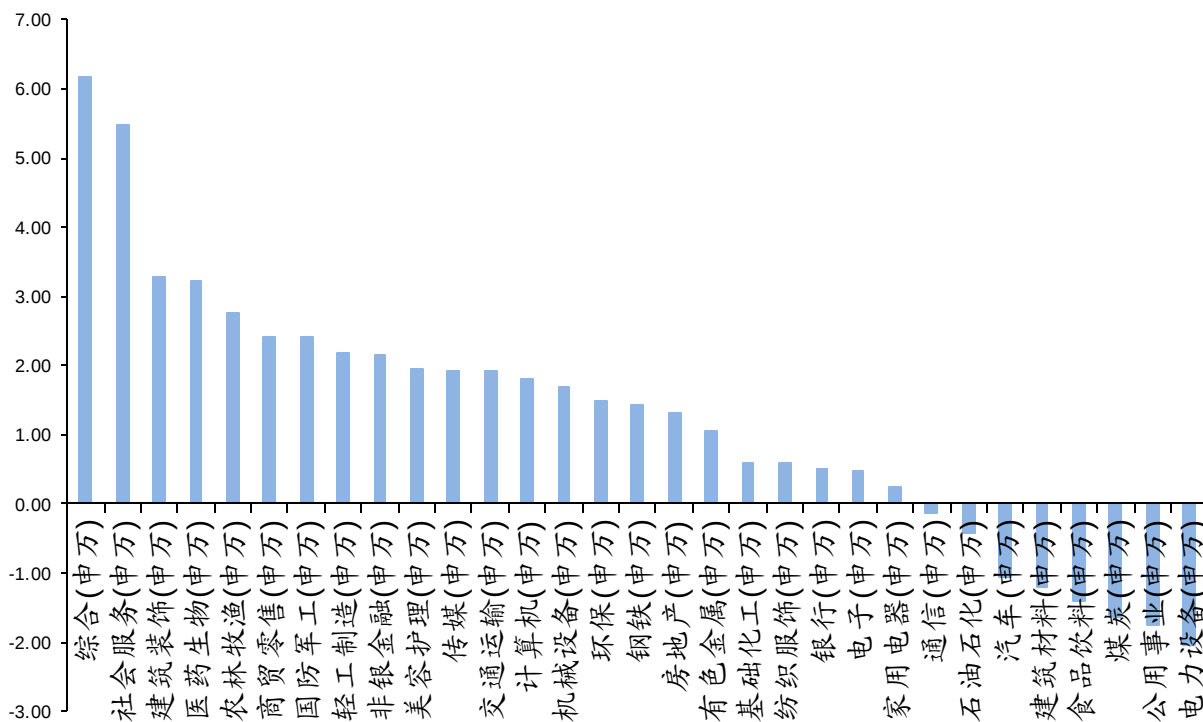
正帆科技：公司坚定推行依托 Capex 业务拓展战略，预计 2024 年 Opex 业务占比将首次超过 20%，并且未来将持续提升。公司积极整合产业资源，依托底层技术布局新能源、科研等新领域。半导体行业扩产推动新签订单高增，材料、零部件助力业绩成长。随着公司募投项目新建产能逐步爬坡，气体业务毛利率积极改善，2023 年公司气体和先进材料业务毛利率为 19.21%，较上一年同期提升 1.48 pcts，未来随着公司气体业务放量，规模效应逐步显现，毛利率将进一步提升。鸿舸半导体的 Gas Box 产品于 2023 年全面稳产，供应链和产能效率提升显著，未来公司或将为半导体设备客户提供其他标准化、通用型的模块和零部件。

洁美科技：需求复苏+新产品验证放量。传统优势业务静待需求回暖，稼动率提升带来利润弹性。中高端离型膜产品顺利拓展核心客户，看好离型膜放量。公司离型膜中粗糙度产品已向国巨、风华等客户供应，已覆盖主要的台系客户和大陆客户。中高端离型膜产品对日韩客户已经进入加速验证的阶段，逐步与三星、村田核心客户建立战略合作关系。2022 年底公司和村田建立战略合作伙伴关系，密切跟进客户需求，加速产品导入和升级，放量确定性增加。

三、板块行情回顾

回顾本周行情，参考申万一级行业划分，涨幅前三名的行业分别为综合、社会服务、建筑装饰，涨跌幅分别为 6.16%、5.49%、3.27%。涨跌幅后三位为煤炭、公用事业、电力设备，涨跌幅分别为-1.63%、-1.75%、-2.04%。本周电子行业涨跌幅为 0.48%。

图表9：板块周涨跌幅排序（%）（2024.7.29-2024.8.4）



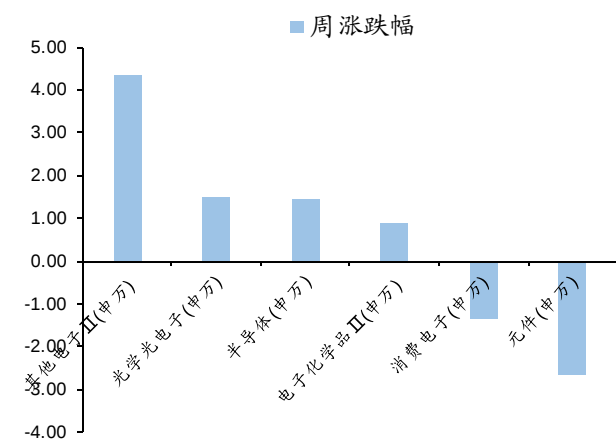
来源：Wind，国金证券研究所

在电子细分板块中，涨跌幅前三大细分板块为分立器件、其他电子、半导体设备，涨幅分别为 4.99%、4.36%、4.19%。



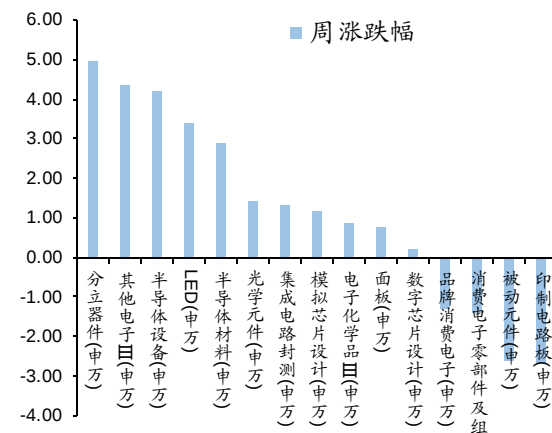
涨跌幅靠后的三大细分板块为消费电子零部件及组装、被动元件、印制电路板,涨跌幅分别为-1.39%、-2.62%、-2.66%。

图表10: 申万二级电子细分板块周涨跌幅 (%)
(2024. 7. 29-2024. 8. 4)



来源: Wind, 国金证券研究所

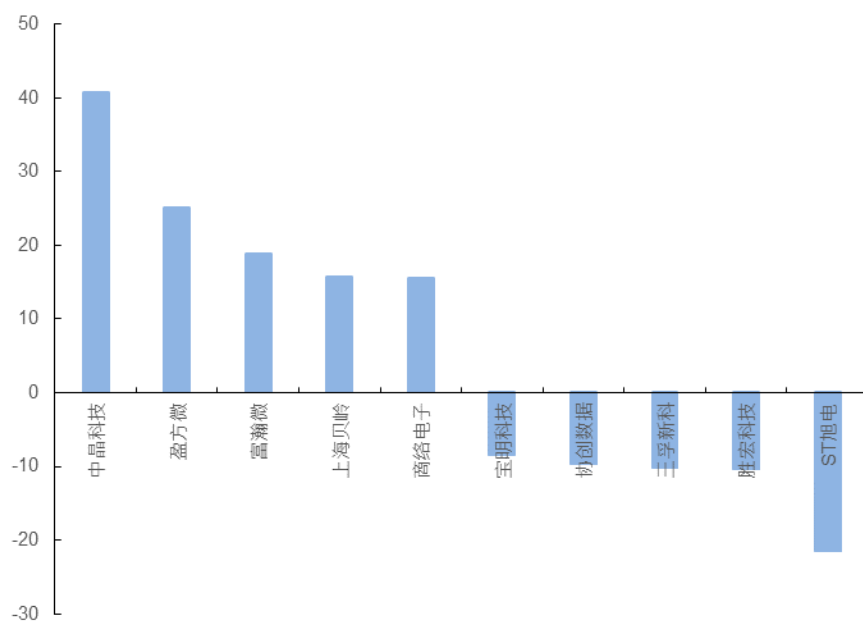
图表11: 申万三级电子细分板块周涨跌幅 (%)
(2024. 7. 29-2024. 8. 4)



来源: Wind, 国金证券研究所

从个股情况来看,本周中晶科技、盈方微、富瀚微、上海贝岭、商络电子为涨幅前五大公司,涨跌幅分别为40.78%、25.12%、18.93%、15.65%、15.59%。跌幅前五为宝明科技、协创数据、三孚新科、胜宏科技、ST 旭电,跌幅分别为-8.50%、-9.68%、-10.23%、-10.32%、-21.43%。

图表12: 电子板块个股周涨跌幅 (%) (2024. 7. 29-2024. 8. 4)



来源: Wind, 国金证券研究所

四、风险提示

AIGC 进展不及预期的风险: 科技巨头公司布局 AI, 存在未来行业竞争进一步加剧、AI 产品不能有效与应用实践相结合的风险。

外部制裁进一步升级的风险: 全球范围内的贸易摩擦不断升级, 若美国、日本、荷兰等国出口管制进一步升级, 可能会导致相关企业的核心环节受限。

终端需求不及预期的风险: 消费类智能手机创新乏力, 对产业链拉动低于预期, 换机周期较长; 若新能源(电动汽车、风电、光伏、储能)需求不及预期, 电动车销量下滑, 光储装机量不及预期, 可能会对相关公司业绩产生影响。



行业投资评级的说明:

买入: 预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上;

增持: 预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%;

中性: 预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%;

减持: 预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。



特别声明:

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发,需注明出处为“国金证券股份有限公司”,且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法,故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致,国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,在不作事先通知的情况下,可能会随时调整,亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用,在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险,可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突,而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品,使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下,国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密,只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》,本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级(含 C3 级)的投资者使用;本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要,不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具,本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资,遭受任何损失,国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告,则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议,国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有,保留一切权利。

上海

电话: 021-80234211

邮箱: researchsh@gjzq.com.cn

邮编: 201204

地址: 上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 5 楼

北京

电话: 010-85950438

邮箱: researchbj@gjzq.com.cn

邮编: 100005

地址: 北京市东城区建内大街 26 号

新闻大厦 8 层南侧

深圳

电话: 0755-83831378

传真: 0755-83830558

邮箱: researchsz@gjzq.com.cn

邮编: 518000

地址: 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心

18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究